

半自动扩膜机

■ 概要

本设备是由扩膜模块、扣环模块、圆切模块、软件控制系统、操作系统等组成的复杂运动系统。用于对切割后的晶圆进行扩膜，以拉大各个芯片之间的间距，便于后续的挑片工艺。

■ 优势

- 采用Kinco触摸屏，进行对设备的参数设置。
- 可采用自动或手动进行操作。
- 可实时显示扩膜的高度。
- 可自动完成扩膜、切膜等操作过程，自动化程度高、安全可靠。



■ 规格

晶圆尺寸	Ø200mm
扩膜高度	20-60mm
扩膜速度	1 mm/Sec - 4mm/Sec
回零速度	1 mm/Sec - 7mm/Sec
高度精度	± 1mm
设备电源	AC-220V ± 15% 50Hz 5A 1.2KW
压缩空气	0.5-0.6 MPa、100L / Min、Ø8气管
环境温度	20°C - 30°C
设备尺寸	700mm (长) × 400mm (宽) × 700mm (高)
设备重量	65KG